Détecteurs de traces

ECOLE IN2P3 "DU DETECTEUR A LA MESURE"

Oléron 17 - 25 juin 2009 P.Siegrist CERN-PH

Plan

- Rappel Interaction particules/matière
- Historique des détecteurs de traces
- Les détecteurs de traces modernes
- Scintillateurs (pour tracking)
- Détecteurs de traces gazeux
- Détecteurs de traces à semi-conducteurs
- Applications & problèmes
- Problématique « gros détecteurs »

Oléron juin 2009

P.Siegrist CERN-PH

Interaction des particules avec la matière

- Tous les phénomènes observés finalement dans les détecteurs de traces sont dus à des interactions de particules chargées
- Généralement on distingue cependant 3 types:
 - particules lourdes chargées (m ~masse du noyau)
 - électrons
 - rayonnement électromagnétique (X, γ)
- Les interactions à considérer sont électromagnétiques.

Les particules détectées par leurs traces

En général on peut en faire des faisceaux

- électron e^- e+ m= 0.511 MeV
- muon μ⁻ μ+ 105.66
- pions $\pi^- \pi^+$ 139.58
- kaon k⁻ k+ 493.84
- proton p⁻ p 938.26
- ($\gamma \quad \nu \quad \pi^0 \quad k^0 \quad n$) ??? !!!

~ 1 GeV

Parcours et atténuation

- Seules les particules lourdes chargées ont un parcours R (range)
- Les électrons subissent de grands changements de direction dus à leur forte perte d'energie par rayonnement électromagnétique (grande valeur de e/m)
- Pour le rayonnement électromagnétique (faisceau γ) l'absorption est exponentielle N=N₀ e^{-λx} avec λ = prob d'interaction/cm

Interaction avec électrons atomiques

Perte d'énergie par ionisation

- Collision de la particule lourde chargée avec les électrons atomiques du milieu traversé.
- La plus grande perte d'énergie se produit lors de ces collisions
- énergie cinétique part. incidente → atome excité ou ionisé

Notations

- M : masse de la particule incidente
- m : masse de l'électron
- Z : Numéro atomique
- e : charge de l'électron
- N : densité de centres diffuseurs (atomes/cm³)
- $\beta = v/c : vélocité$
- γ : Facteur de Lorentz, $\gamma = 1/\sqrt{(1-\beta^2)}$
- z : charge de la particule incidente (en unités de e)
- η : Energie de transition séparant petits et grands transferts
- ∆E_{max} : Energie cinétique maximale transférable par la particule incidente sur un e- au repos.

Bethe-Bloch



$$\frac{dE}{dx} = -2\pi N Z \frac{z^2 e^4}{m\beta^2} \left(\ln \frac{2m\gamma^2 \beta^2 E_{cut}}{I^2} - \frac{\beta^2}{2} \left(1 + \frac{E_{cut}}{\Delta E_{max}} \right) - \frac{\delta}{2} \right)$$

Diffusion multiple

- Diffusion coulombienne sur un noyau = répulsion électrostatique par le noyau = diffusion de Rutherford = collision nucléaire élastique → dσ/dΩ ~1/sin⁴ (θ/2)
 - Grand changement de la direction de la particule mais pas grande variation d'energie en moyenne
- Effet cumulé de plusieurs collisions = diffusion multiple → dist Gaussienne

$$\theta_{0} = \frac{13.6 \text{ MeV}}{\beta cp} z \sqrt{\frac{L}{X_{0}}} \left\{ 1 + 0.038 \ln\left(\frac{L}{X_{0}}\right) \right\} \qquad X_{0} = \frac{716.4 \text{ g.cm}^{-2}A}{Z(Z+1) \ln(287/\sqrt{Z})}$$

Caractère semi empirique affiné suivant les progrès expérimentaux et moyens de calcul.

"Vieille formule":

$$\sqrt{\langle \theta^2 \rangle} = \frac{15Z}{p\beta} \sqrt{\frac{L}{L_{rad}}}$$

La préhistoire

- Emulsions photos
- Chambre à brouillard (vapeur sursaturée, traces provoquent ionisation et apparition de gouttes le long des traces)
- Premières utilisations dans les exp. de rayons cosmiques
- Les compteurs Geiger

Un peu plus tard

- Chambres à bulles 1952 (Glaser)
 - 1965 ch. 2m du CERN
 - 1970 80 Mirabelle Gargamelle BEBC
 - Principe: H2 ou liquide lourds (propane) en phase liquide proche de la phase gazeuse (Pc, Tc) Détente → état surcritique et apparition de bulles le long des trajectoires
 - Si champ magnetique → traces courbées
 - R = P/0.3H R en cm, P en Mev/c , H en KGauss
 - Synchro du faisceau et de la détente.
 - 1 seule photo donc nombre limité de particules à envoyer
 - Détente P de 4 atm à 1.3 atm @ T 24 à 27 K
 - Durée: détente 10 ms, faisceau 5ms, photo 7 ms, re-compression 10 ms

Total ~ 30 ms

Et en même temps

- Compteurs à étincelles (compteur proportionnel)
- Chambres à étincelles (1965-1975)
 - Gaz entre 2 plaques avec ΔV = 2-3 KV
 - Temps de mémoire de 10 à 100 μs
 - Détection de l'étincelle optique, sonique, fil magnétostrictif...
 - Si pulse HT < 20ns l'étincelle suit la trace
 - Si pulse HT <10ns chaque électron donne une avalanche. Pour champ ~ 15 KV/cm avalanche lumineuse. Si on coupe la HT rapidement (avant passage du courant → chambre a dards (streamer)

1968...

- <u>G.Charpak</u>:Chambre proportionnelle CPMM, ou MWPC. « Mise à plat » du compteur proportionnel cylindrique
- Plan de fils de lecture entre 2 plans (grilles) HT
- Bonne résolution en temps (faible temps de mémoire, sépare 2 traces à moins de 200 ns
- Pas de déclenchement HT
- Premiers spectromètres ~ 1970
- Rapidement chambres de grandes dimensions $60x60 \text{ cm}^2 \rightarrow 1.3x1.3 \text{ m}^2 (1973) \rightarrow 4x4 \text{ m}^2 (1978)$

Améliorations et variantes

- Travail sur le gaz (gaz "magique")
- Lecture 2 coordonnées
- Lecture sur cathodes (signal induit)
- Chambres à dérive
- Cathode segmentées
 <u>Chambres damiers LAL exp NA3 1978</u>
- Géométries cylindriques pour les collisionneurs
- Enormes progrès en permanence sur l'électronique

Les chambres à dérive

- Concept post MWPC: Chambres à dérive planes (F.Sauli)
- Plan de fil = alternance fils de champ-fils sensible.
- On ne mesure que 1 fil sur 2 (moins d'électronique ou plus de surface pour le même prix)
- On mesure le temps d'arrivée sur le fil sensible

Un Point d'Histoire... La TPC LBL PEP-4

PROPOSAL FOR A PEP FACILITY

BASED ON THE TIME PROJECTION CHAMBER

A. R. Clark, O. Dahl, P. Eberhard, D. Fancher, L. Galtieri, M. Garnjost, R. W. Kenney, S. C. Loken, L. T. Kerth, R. Madaras, D. R. Nygren, P. Oddone, M. Pripstein, P. Robrish, M. Ronan, G. Shapiro, M. L. Stevenson, M. Strovink, H. Wenzel, and M. Urban[↑]

> Lawrence Berkeley Laboratory University of California Berkeley, California 94720

C. D. Buchanan, J. M. Hauptman, W. E. Slater, D. H. Stork, and H. K. Ticho

Department of Physics University of California Los Angeles, California 90024

J. N. Marx**, P. Némethy, and M. E. Zeller

Department of Physics Yale University New Haven, Connecticut 06520

W. Gorn, A. Kernan, J. Layter, and B. Shen

Department of Physics University of California Riverside, California 92502

B. A. Barnett, C-Y. Chien, L. Madansky, J. A. J. Matthews, and A. Pevsner

Department of Physics Johns-Hopkins University Baltimore, Maryland 21218

* Scientific Spokesman.

+ Visitor from Ecole Polytechnique, 1974-1976.

** Deputy Scientific Spokesman, Visitor LBL, 1976-1977.



P.Siegrist CERN-PH

Idée Originale

D. R. Nygren: "Proposal to investigate the Feasibility of a Novel Concept in Particle Detection", LBL internal report, Feb. 1974

Aux nouveaux accélérateurs e+e- (PEP, PETRA), il faudra mesurer des jets d'environ 15 particules (12 chargées), sur une acceptance de 4π stéradians avec une très haute efficacité, pouvoir mesurer précisément les impulsions, identifier les particules, mesurer les énergies et les directions de tous les photons émis et être insensible au bruit de fond supérieur de plusieurs ordres de grandeur.

Approche conventionnelle: gros solénoïde + détecteur très segmenté (EXB) + identification (dE/dx sur au moins 100 échantillons) difficile!

→ Nouveau concept E // B et longue dérive pour la coordonnée z

Concept de longue dérive

- Si B et E // une longue dérive est possible, limitée par HT max. → 1m ou plus. (150 KV max!)
- •Vitesse de dérive
- •Diffusion transverse «réduite » par B → B=1.5 T
- •Choix judicieux du gaz, exemple Ar-CH4
- •Vd ~ qq cm/ μ sec \rightarrow résolution en z de 1mm sur 1m

Diffusion transverse

Elargissement de la trace au cours de la (longue) dérive L σ ~ (D. L)^{1/2}

> D =coefficient de diffusion D = Vx($\lambda/3$), V vitesse des électrons, λ =parcours moyen dans le gaz

Si B champ // et E champ de dérive $V \sim [\mu/(1+(w\tau)^2)]$. E

Avec μ =(e τ /m_e) mobilité des électrons, τ temps moyen des électrons entre 2 collisions et ω = eB/m_e fréquence cyclotron de l' électron

ω τ peut varier de 1 à 10...!

Résolution spatiale

Mesurer sur des pads les signaux positifs issus du mouvement des ions positifs générés près de l'avalanche sur le fil proportionnel (Charpak et al.)

Etendre la charge sur 2 ou 3 pads → mesure du centre de gravite

→ Amplificateurs de bas bruit sur cathode segmentée



Résultat



Table IIIA.1	
TPC Operating Conditions	
→ B	= 15 KG
Gas:	80% Argon + 20% CH ₄
E/P:	0.2(V/cm/Torr)
Ε:	150 KV/m
Pressure:	10 atmospheres
Drift distance:	1 m
Momentum resolution:	≈0.6% × P(GeV/c)
Drift velocity:	~7 cm/µs
Spatial resolution:	$\triangle z: 2 mm$
	Δφ: <u>150 (μm)</u> R
<pre># readout elements:</pre>	9600
<pre># wedges/endcap:</pre>	6
<pre># dE/dx wires/wedge:</pre>	192
<pre># spatial wires/wedge:</pre>	12

Electronique

Préampli faible bruit (1000 e RMS) FET à l'intérieur du volume (à qq cm du pad ou du fil) (Preamp ~ 110mW). Refroidissement

•Ampli-shaper distant (salle de comptage)→shaping pour résolution en temps et en amplitude

 Stockage analogique de l'information en temps et amplitude → registres à décalage analogique: CCD Fairchild, vitesse avec horloge externe. 15 MHz, 240 échantillons (tous les 4mm). Vidange a 20-50 KHz.

•Opération à température de 10 degrés C !

•Courant noir, piédestal dépends du bucket

Oléron juin 2009

P.Siegrist CERN-PH

Electronique TPC PEP4



Fig. IIIA.10

Secteurs TPC+ Cables







Fig. IIIA.4

Lecture TPC

- Stockage info analog. Dans CCE
- Relecture à 20KHz (50 msec)
- r = numéro du fil (12)
- ϕ = numéro du pad
- z = ccd bucket
- Zéro suppression
- par priorités sur ADC
- Pads 8 bits
- Fils 9bits



Fig. A10.2

Complications

Forte amplification sur les fils →charge d'espace du nuage d'ions lents →distorsions

➔opération en "gating grid". Perturbation sur électronique, moins de gain sur la chambre et plus de gain demandé aux amplis.



DETAIL OF WIRE GEOMETRY

Effets E X B au voisinage des

fils (gradient de champ) et

bords de cages et secteurs

discontinuités de champ

"gating grid"



Appliquer V_g+/- DV_g sur grille de gate DV_g = 100V dynamique ou 30 V statique •TPC gate fermée + ouverture après trigger L1 OK Perte début trace + perturbation électronique •Ouverture permanente +fermeture après L1 NO •Générateur pulse + et - très symétriques !

Va+AV



Figure 4.39: Block diagram of the gating pulser.

P.Siegrist CERN-PH

TPC PEP4 Conclusions

• A établi l'idée et les principes de base + validation

LA TPC C'EST POSSIBLE!

- Sera l'inspiratrice des TPC de LEP
- A montré la possibilité d'utiliser un chaîne de préamplisamplis à haut gain et faible bruit.
- Devant les difficultés d'utilisation a poussé la recherche sur les FADC

•dE/dx optimiste

Les TPC à LEP Aleph (1983-1989-2000)Delphi



TPC Delphi



TPC Delphi: caractéristiques



12 x 1680 pads, 12 x 192 fils → 22464 canaux

TPC Delphi:secteurs et cage HT



TPC Delphi:champs électriques et grilles

E= 150 V/cm, HT~20 KV





Gate pulsée ou statique

TPC Delphi




TPC Delphi: chaîne électronique



Schéma de la chaîne électronique









TPC Delphi:préamplis et amplis

- Préampli: BF 992 MOS-FET
- Hybride: pole zéro + émetteur de ligne
- Dissipation 42 mW
- 16 hybrides/carte (alu + refroid. tuyau eau)
- Ampli-Shaper: 2 sections ampli-filtre actif
- Shaping 170 ns FWMH
- Receveur de ligne sym. 2 x 60 W
- Controle de gain (sw) steps < 1%
- 32 hybrides/carte FB
- Discris pour trigger (fils)
- Bruit pads 500 e- sur 5 pF, fils ~1000 e-
- à 20 pF



TPC Delphi: digitiseurs

- Buffer d'entrée dif. Thomson LM318
- 8-bit FADC Thomson EF 8308 15 MHz
- Caract. Bilinéaire, pas de 6.0 mV de 0 à 191 et 29.7 mV de 192 à 255.
- Input max 3V, dynamique 500.
- +- 1 LSB intégrale et 0.7 LSB dif.
- Mémoire en 4 pages de 512 bytes pour 4 événements de 511 tranches de temps (70 ns)
- 48 x 2 canaux par 3 U FB + carte ZS





TPC Delphi: digitisation & relecture

<u>Digitisation:</u> le FADC tourne en permanence. A chaque BCO (50KHz) le résultat est écrit dans une page mémoire au moins durant 2μ s (attente trigger niveau I), puis soit l'événement est rejeté la plupart du temps et le pointeur mémoire est remis à 0, soit est gardé (1 KHz max) et l'écriture se poursuit pendant toute la durée de la dérive, 511 tranches de temps = 35 µs pour une horloge à 14.67MHz. Ecriture en // dans toutes les 96 voies d'un digitiseur.

<u>Zéro suppression et formatage:</u> c'est le processus concurrent permis si le FADC n' écrit pas dans sa mémoire. Relecture de la mémoire, « clustering » en temps (tranches de temps adjacentes qui dépassent un seuil), fabrication d'une table de pointeurs (fixe) et formatage des clusters. Relecture en série des 96 voies, 1 seul ZS (automate HW) pour 96 voies de digitiseur. Info ZS dans mémoire de 2Kbyte/digitiseur.

Les digitiseurs de plusieurs châssis FB (FB clusters) sont lus par des processeurs de châssis (<u>Fastbus Intersegent Processor FIP</u>, MC68020). Taches principales: démarrage ZS si place mémoire, relecture mémoire de ZS et formatage, monitorage, calibration, clusterisation pour trigger niveau III (soft).

TPC Aleph 1 The Time Projection Chamber (TPC)

Description: Cylindrical drift volume with central electrode and planar wire chambers at the two ends. Electrons from ionization drift to the endplates along the electric field of 11 kV/m. Their charge is recorded by a system of proportional wires which are capacitively coupled to cathode readout pads. Each endcap has 6 inner sectors (type K) and 12 outer sectors (types M and W). Sectors have concentrical rows of pads for 3 dimensional coordinate measurement (r\$\$ from pad position, z from drift time). Wires across the sectors are used for dE/dx measurements. Each sector is equipped with special trigger padrows.

Gas: ArCH4 (91 % : 9%) at atmospheric pressure.

Dimension:	Radius:	$R_{\text{outor}} = 1.8 \text{ m}$	$R_{inner} = 0.31$ in
	Civerau lengui	4.CIL	
	Dritt length	2 X 2 2 10	
	Weight	3.6 t (with cables)	
	Gas volume	43m ³	and the set of the
	Radiation length:	inner fieldcage	0.023 X ₀
		outer fieldcage	0.048 Xo
		endplate	0.35 X ₀



TPC Aleph



Fig. V.1 TPC overall view.



Fig. V. 14 a) Overall geometry of the TPC end-plate. b) A more detailed view of M, W, and K sectors.

--- r = 0

TPC Aleph

Soctors:	R _{min}	Rmax	No. padrows	No. trig. padrows	No. wires
Турс К	38 cm	9lcm	9	8	148
Type W,M	100 an	170cm	12	11	196

Pad size	6.2 x 30rere ²
Pitch in r-o	6.7 mm
Triggerpad size	6.8 mm ×150
Sense wire spacing	4 1010
Sense wire diameter	20 µm
Field wire diameter	127 pm
Diameter of other wires	76 µm
Central electrode thickness	25 µm

Gas Properties: Drift velocity

Longitudinal diffusion Transverse diffusion (B=15kG) Specific ionization for min. i. p. (mean)

5.2cm/ μs 4mm/ \sqrt{m} per single electron. 0.8mm/ \sqrt{m} per single electron. 90 electrons/cm

Readout:

[pads	WITCH	total
Channels	2×20502	2×3168	47340
TPDs	660	108	768
TPPs	36	36	72

Performance:	rø spatial resolution	180µm at 0 ⁰ pad crossing angle		
	z spatial resolution	1.2 mm (wires) with "small" z dependence		
	-	0.8 mm (pads) at $\theta = 90^{\circ}$		
	Momentum resolution	on $\Delta p/p^2 =$ TPC only: $1.2 \times 10^{-3} (GeV/c)^{-1}$ at 45 GeV ITC + TPC: $0.8 \times 10^{-3} (GeV/c)^{-1}$ at 45 GeV		
	dE/dx resolution	4.5% for Bhabha electrons		





Oléron juin 2009

P.Siegrist CERN-PH

TPC Aleph: électronique

- Préampli intégration de charge
- 25 e- primaires = 1MIP→15 mV
- = 1/4 du range dynamique FADC
- Bruit 600 e-. 50 000 preamp
- <u>Shaper:</u> receveur diff + pole zero
- + 2 filtres 1 MIP →0.5 V peak sortie
- shaper
- Largeur pulse 230 ns FWHM
- Ampli & shapers hybrides
- FADC: Thomson 8 bit
- (comme Delphi)



Fig. V.22 Functional diagram of the analog electronics chain.



Fig. V.23 Circuit diagram of the pad amplifier.

TPC Aleph





Fig. V.73 The measured *dE/dx* versus particle momentum for a sample of about 40,000 tracks. Each track was required to have at least 150 *dE/dx* measurements. The fitted parametrization is overplotted for electrons, muons, pions, kaons, and protons.

Les TPC à LEP: conclusion

Lep a été la machine idéale pour exploiter tout le potentiel des TPC:

- •Utilisation optimale des "longues dérives". BC @ 50KHz
- •Peu de bruit de fond...
- •Evénements physiques!
- •Electronique/taille optimale
- •Electronique « solide »
- Investissement rentabilisé (89→2000)

1 fil casse apres 10 ans...



Les TPC après le LEP



Expériences ions lourds cible fixe

Ions lourds CERN Hall Nord SPS:

- •NA35 (1990):, TPC 125 x 240 x 112 cm3, hors champ magnétique... Comptage de traces droites
- •NA45 CERES
- •NA49 (1995)

BEVALAC Berkeley: EOS (1992-93)

PS CERN: HARP expérience programme neutrino (2001-2002)

Expériences ions lourds collisionneurs

STAR à RHIC (Brookhaven-USA) (2001)

Alice au LHC CERN

Electronique:Filière LBL EOS → NA49 → STAR

TPC EOS



TPC EOS

HISS TPC Characteristics			
Pad Plane Area	$1.5m \times 1.0m$		
Number of Pads	$15360 (120 \times 128)$		
Pad Size	$12mm \times 8mm$		
Drift Distance	75 cm		
Time Sampling Freq.	10 MHz		
Signal Shaping Time	250 ns		
Electronic Noise	700 e		
Gas Gain	3000		
Gas Composition	$90\% Ar + 10\% CH_4$		
Pressure	1 Atmosphere		
B Field	13 kG		
E Field	120 V/cm		
Drift Velocity	$5 \text{cm}/\mu \text{ s}$		
Event Rate	10-80 events/ 1 sec spill		
dE/dx range	$Z = 1-8, \Lambda, \pi, p, d, t, He, Li - O$		
Two Track Resolution	2.5cm		
Multiplicity Limit	≈ 200		

TPC EOS: Electronique

15360 pads à lire

Electronique à 700 e-

- →grande gamme dynamique, haute densité, bas prix
- •4 canaux préamp. CMOS intégré
- •Ampli shaper « surface mount » techno
- •16 canaux SCA (switched capacitor array) 10 MHz input
- ADC commercial

TPC EOS:dE/dx pads



TPC NA 49







TPC NA 49:taille et nombres de canaux

TPC:	VTPCs		MTPCs		
Length:	260 cm		$384 \mathrm{cm}$		
Width:	200 cm	ı	384	$384 \mathrm{cm}$	
Height:	72 cm		$129 \mathrm{cm}$		
Drift distance:	69 cm		115 cm		
Drift voltage:	13 kV		16.5 kV		
Gas mixture:	Ne/CO	2	$\rm Ar/CH_4/CO_2$		
Gas composition:	91/9	91/9		91/4.5/4.5	
	VTPC1:	VTPC2:	HR:	SR:	
Sectors per TPC:	6	6	5	20	
Pad-rows per sector:	24	24	18	18	
Pads per pad-row:	192	192	192	128	
Number of pads/sector:	$4,\!608$	$4,\!608$	$3,\!456$	$2,\!304$	
Pad width:	$3.0 \mathrm{mm}$	$3.0 \mathrm{mm}$	3.13 mm	$4.95 \mathrm{mm}$	
Pad length	16 mm/28 mm	28 mm	$39 \mathrm{~mm}$	$39 \mathrm{mm}$	
Gap sense-wire/pad-plane:	$3 \mathrm{~mm}$	2 mm	2 mm	$3 \mathrm{mm}$	
Number of pads per TPC:	27,648		63,360		
Total number of pads:	182,016				

TPC NA49:Front End



TPC NA49: Données brutes



MTPCR

Beam ->



TPC STAR

- •L = 4m, 0.5m < R < 2m
- •B = 5 kG
- •136 600 pads en 45 rangées /endcap
- •Electronique similaire à NA49

•S/N = 20:1, range dynamique 10 bit, shaping 180 ns FWHM, digitization @6.3 ou 13.8 MHz



TPC STAR Golden Events



P.Siegrist CERN-PH

HARP





~ OK en juillet 2001

HARP:Electronique

- Analog FE: preamp/shaper CALICE3(SMB302A)Alcatel
- Low impedance current preamplifier / shaper / baseline restorer.
- Four channel per die.
- Design in a fast complementary bipolar process form INTERSIL
- Digital: CERES (modifie) FEDC
- ALTRO



TPC ALICE



TPC ALICE

Table 5.1: Front-end electronics requirements.

Parameter	Value	
Number of channels	570132	
Signal-to-noise ratio (MIP)	30:1	
Dynamic range	900:1	
Noise (ENC)	1000 e	
Conversion gain	12 mV/fC	
Crosstalk	< 0.3%	
Shaping time	about 200 ns	
Sampling rate	5.66(-7.69) MHz	
Tail correction after 1 μ s	0.1%	
Bandwidth to DAQ/Level-3	8.4 GByte/s	
Maximum dead time	10%	
Power consumption	< 100 mW/channel	

Futur pour les TPC ?

- NLC/ILC ??
- Autres Machines ?
- Ions lourds → OK
- Associer longue dérive + nouvelles techno ?
 Silicium Micro-strips
 - Autres ?

Scintillateurs

- Scintillateurs organiques
- Lecture via guides de lumière par tubes photo multiplicateurs
- Géometries détection traces
- Fibres scintillantes + tubes multi anodes

References C. D'Ambrosio Particle Detectors Cern Academic training 2004/2005

Scintillation



Dépôt d'énergie par une particule ionisante: -Génération -Transmission -Détection de la lumière produite par scintillation

Scintillateur organique (plastique)
~ 10 000 photons/MeV
bas Z, ρ ~ 1g/cm³ → relativement léger
dopage => choix longueur d'onde d' émission
temps de « decay » qq ns
→ Tracking, TOF, Trigger, compteur veto
Moyennement tolérant aux radiations…
Lecture?

Mécanisme de scintillation organique


Scintillateurs organiques pour traces



Scintillateurs organiques pour traces



Scintillateurs organiques pour traces



Pourtant très utile! Test Tracker Si strips TIB → en 2005

Lecture par « PM clasique »

P.Siegrist CERN-PH

Scintillateurs

Géométrie et usage

Déclenchement (Trigger) sur faisceau incident
Coïncidences multiples (signal 1 à 10 ns)
Compteurs veto (signal +large)

•Positionnement faisceau incident (mini hodoscope)

- i. Scintillateur mince
 - ii. Guide à air
- iii. Corrélation position vs p
- iv. Scintillateurs « fingers »
- Temps de vol (TOF) + position
 - Fibres scintillantes

Fibres scintillantes



Détecteurs de traces gazeux

- Détecteurs pour hauts flux
 - MSGC
 - GEM
 - Micromegas
- Détecteurs muons LHC
 - CMS: DT, RPC,CSC
 - Atlas:TGC
 - LHCB: MWPC, GEM

MSGC

- Début des années 90
- Comment faire des détecteurs de trace supportant les très hauts flux? Tracker LHC
- Grande segmentation, petites chambres, petites cellules (200 μ m), collection de charge rapide
- Silicium trop cher (et trop petit)
- Chambres classique →1 mm de pas de fil mini.
 Précision & tolérances mécanique
- Adapter des techniques de micro électronique pour un compteur à gaz sur un substrat moins cher...
- → MSGC sur substrat de verre (spécial) avec amplification gazeuse

MSGC

Principe



R. Bellazzini

Champ électrique



MSGC technique de fabrication

Lift off



MSGC

Etudes & tests extrêmement poussés sur

- Type de substrat (verres spéciaux)
- Matériaux rad hard
- Gaz
- Vieillissement
- Faisceaux intenses
- **→**~ OK

Mais finalement solution abandonnée...



MSGC



Variantes

• GEM (Sauli)

Micromegas
 (Charpak, Giomataris)

GEM 1997

(R. Bouclier et al., NIM A 396 (1997) 50)





Triple GEM LHCb Muons

Micromegas NA48

Micromegas Time Projection Chambers









PRODUCTION SEQUENCE OF A BULK MICROMEGAS

OPERA



OPERA Trackers in pictures & numbers

September 11th, 2006

5900 m² scintillator detectors – 3050 m² Resistive Plate Chambers_{LNGS} and the Neutrinos 8064 7m long drift tubes - ~2000 tons of Fe from CERN





Oléron juin 2009

P.Siegrist CERN-PH

Detecteur OPERA-CNGS

Detecteur electronique: trigger sur interaction neutrino identification du muon et mesure charge et impulsion



OPERA

Briques: Cible active Pb + Em 31 plans, 206336 briques, 1766 tonnes

1 brique = 56 Pb + 57 Em









υ Interaction From NUMI exposure



Reconstruction dans l' émulsion



Vertex detection :

Neutrino interaction and decay of short lived particles

Detection of ν_{τ}^{CC} in DONUT

Oléron juin 2009

region (4179 tracks)

OPERA

Détecteurs muons LHC

– CMS: DT, RPC,CSC





Atlas:TGCLHCB: MWPC, GEM

Muons CMS



Muon Barrel



Muon End Cap

Oléron juin 2009

P.Siegrist CERN-PH

MWPCs in the LHCb Muon System

K. Mair IEEE 2005





- Multi Wire Proportional Chambers (MWPCs):
 - Fast muon triggering
 - Muon identification
- 5 Muon Stations, 4 Regions / Station
 - 20 different chamber sizes
 - 1368 chambers

MWPC Design

• 4-gap MWPC

- K. Mair IEEE 2005
- gap size: 5 mm (wire plane centered)
- gas mixture: Ar/CO₂/CF₄ (40:55:5)
- wire: Gold-plated Tungsten, 30 µm Ø, 250 to 310 mm wire length
- wire spacing: 2 mm, mechanical tension: 65 gr
- HV = 2.650 kV
- field on wires: 262 kV/cm
- field on cathodes 6.2 kV/cm
- gas gain: G ≈ 50 000
- gain uniformity: $\leq 30\%$
- panel production:
 - PCB coated by 35 μm copper,
 5 μm nickel, 0.2 μm gold
 - foam injected between 2 PCBs in mould









Détecteurs Silicium

- Micro Strips
 LEP→ détecteurs de vertex
 LHC détecteurs de traces Atlas, CMS
- Pixels
 - Débuts à LEP (P. Delpierre et al. Delphi)
 - LHC Alice, Atlas, CMS

SI Micro-strips CMS

3.1. Substrate

The supplier shall provide the silicon substrates. They have 6" diameter for thick sen and thin wedge sensors, and either 6" or 4" for the thin inner barrel sensors. They are:

n-type, phosphorus doped, float-zone, <100> crystal orientation resistivity in the range of = 1.5 - 3.0 K cm (thin sensors) resistivity in the range of = 3.5 - 7.5 K cm (thick sensors) thickness: 320±20 µm (thin), 500±20 µm (thick) Both sides polished.

3.2. Dicing and Flatness

The sensors shall be diced by the supplier. The dicing tolerance is ± 20 µm. The qualit the cut edges shall be such that there are no chips greater than 40 µm and no cracks. sensors shall be clean, with no residual on the surface when delivered.

We require a sensor flatness (unstressed) <100 µm.





6450 détecteurs épais. 320 μm

Module



- •2 détecteurs
- •Pitch adapt
- •Hybride elect.
- •Cadre (non présent)





Assemblage en structures



Outer Barrel



Rods → 6 couches Outer Barrel

Oléron juin 2009

INNER BARREL FORWARD



Inner barrel 2 x 4 demi couches

Forward: Pétales→2 x 11 disques à 6 anneaux

Si CMS

- Pas "trop" cher
- Robuste
- Bonnes performances (S/N > 20)
- Pas de gaz!

Mais

- Production "industrielle"
- Opération à -15°C
- Cooling! (C6F14)
- Aspect "système" reste lourd...
- (Alim LV et HV, plomberie, masses...)
- Lecture et Contrôle

CMS Tracker readout and control architecture



Read-out and control architecture



Signals



A.Dierlamm

Resolution

Sepembre 2004

- Analysis of the data done with AC1Analysis (written by R. Brauer). Output of cluster positions and heights further processed.
- Simple line fit to cluster positions
- Subtracting residuals gives first approximation of resolution
- We had straight tracks in May and inclined tracks (6°) this time => resolution improved for inclined tracks since in average 2 strips are in a cluster Graph

Rod ID	σ_may (μm)	σ_sept (μm)
	straight tracks	6° inclination
166 (DS)	45	29
154 (SS4)	45	34
112 (SS4)	42	38
124 (SS6)	35	28
13 (SS4)	54	33
153 (DS)	50	30



$$(\sigma_{max} = pitch(183\mu m) / \sqrt{12} = 53 \mu m)$$
Télescope de faisceau



12 Modules TOB

Test en Champ Magnétique Novembre 2004

Oléron juin 2009

P.Siegrist CERN-PH



110

T E C

Tracker CMS Installation et tests finaux

Installation dans le détecteur début 2008

 Tests OK

 Problèmes sur infrastructure de refroidissement (depuis 2007)
 Echangeurs saumure-C6F14 HS → opération tout C6F14

 Test finaux sur cosmiques juillet 2008

 Test sur 3 millions de « triggers cosmiques » octobre 2008

Tracker CMS : quelques exemples de traces en juillet 2008







P.Siegrist CERN-PH



Pixels

- Pixels LHC
 - Alice
 - Atlas
 - -CMS
- Développements « futurs »
 - CMOS
 - Si Amorphe



Pixels CMS détecteur final





n+ on n substrate 150x100µm pixel distance between pixel implants 20µm (Gap) DOFZ (standard FZ material enriched with oxygen) inter-pixel isolation moderated p spray

Eléments des pixels CMS



P.Siegrist CERN-PH

B Pixels CMSR. Horisberger et al.



CMS F Pixels S. Kwan (Fermilab)







Experiment needs 672 plaquettes (7 types and 5 types of sensor module) assembled on 192 panels (4 types). Two panels placed back-to-back on Al cooling channel to form a blade



CMS pixel Structures



Oléron juin 2009

P.SIEGHSL CERN-PH

TZU







Pixels CMS

Insertion juillet 2008 B pixels OK Réparations F pixels Janvier 2009 (contacts & cooling)

Le Tracker de CMS D. Abbaneo CERN-PH

	μ-Strip tracker	Pixels
3 couches de pixels	~210 m ² de silicium 9.3M canaux	~1 m ² de silicium 66M canaux
remplacables 10 couches micro-strips	73k APV25s 38k links optiques 440 FEDs	16k ROCs 2k links optiques 40 FEDs
4 double face 6 simple face	16 types de modules 300-500 μm	8 types de modules 300 μm
End-caps idem	15 K détecteurs	1440 détecteurs
	~33kW	~3.6kW
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	d'occupation @ 10 ³⁴ ixels: 10 ⁻⁴ ner Strips: 3×10 ⁻² Outer Strips: 10 ⁻²
Oléron juin 2009	P.Siegrist CERN-PH	122

Détecteurs CMOS

Det Vertex:Linear Colliders-ILC

STAR, CBM



bande de conduction

région de la diode



Propriétés et Avantages des Capteurs CMOS

M. Winter et al.

Si basse résistivité (type p) avec puits de coll. (type n)

• Signal créé dans couche épitaxiée (dopage faible):

Q \sim 80 e-h / $\mu m \mapsto$ signal \lesssim 1000 e $^-$

- Collection de charge par jonctions n-well/p-epi
 - → les porteurs de charge diffusent thermiquement vers les jonctions, aidés par les réflexions sur les interfaces avec les puits p et le substrat (dopage élevé)

Avantages spécifiques des capteurs CMOS:



- \diamond μ circuits de conditionnement du signal intégrés dans substrat du capteur (System-on-Chip) \mapsto compact, flexible
- \diamond Epaisseur du volume sensible (\sim couche épitaxiée) \sim 10–15 μm \longrightarrow amincissement à \sim 30–40 μm permis
- ♦ Technologie de production standard de masse → runs (multi-projets) fréquents, coûts de R&D réduits
- ♦ Fonctionnement à température ambiante

> Compromis attrayant entre granularité, budget de matière, radio-tolérance, vitesse et consommation

▶ Mais : \Rightarrow volume sensible mince \Rightarrow signal de faible amplitude (mV !)

ightarrow volume sensible \sim non déplété \Rightarrow impact sur la radio-tolérance & la vitesse

← paramètres de fab. dictés par impératifs commerciaux ⇒ impact sur les performances & la radio-tolérance



M. Winter et al.

 $1\sim$ 30 capteurs ou μ circuits fabriqués depuis 1999 :

- exploration des technologies de fabrication : épaisseur épitaxiée, profil de dopage, *I*_{fuite}, ...
- design du pixel : collection de charge, atténuation du I_{fuite}, radio-tolérance, ...
- μ circuits de conditionnement du signal : CDS/pixel, discri. & ADC en périphérie, Ø, ...
- petits proto. → capteurs taille réelle: uniformité des perfo., rendement de fab., amincissement, etc.
- ullet optimisation du design générique pour chacune des \geq 6 applications aux spécifications différentes

Résultats des études (labo avec source ⁵⁵ Fe – faisceau CERN et DESY avec télescope à micro-rubans) :

- $B \sim 10-15 \text{ e}^-$ ENC; S/B $\sim 20-30 \rightarrow \epsilon \gtrsim 99.9$ % (T $\leq 40^{\circ}$ C); O($10^{-4/-5}$) hits fantômes
- $\circ \sigma_{sp} \lesssim$ 1 / 1.5 / 2 / 3 μm pour pixels de 10 / 20 / 30 / 40 μm de côté
- Tolérance aux rayonnements intenses:
 - rightarrow ionisants : 1 MRad (design "rad. tol." des pixels, T < 0)
 - rightarrow non-ionisants : 10¹² 10¹³ n_{eq} /cm² (varie avec pitch, volume sensible, T, etc.)

CMOS-ILC

Trajectométrie : Applications à Court ou Moyen Terme

Extension du détecteur de vertex de l'exp. STAR (RHIC/BNL)

- ullet 2 couches cylindriques : \sim 1600 cm 2
- ullet \gtrsim 160 millions de pixels (pitch \leq 30 μm)
- 3 étapes :
 - 2007: télescope (3 capteurs) installé dans l'exp.
 - \hookrightarrow taux de comptage mesuré, pas de pick-up !



M. Winter et al.

- $\diamond~$ 2008: 2 ou 3 secteurs (8 ou 12 échelles) avec capteurs à signaux numérisés sans Ø (\leq 640 μs)
- $\diamond~$ 2010: tout le détecteur avec capteurs à Ø intégrée (\leq 200 μs)

Télescope de faisceau (projet EUDET/FP6)

- 2 bras de 3 plans (plus 1 plan de haute résolution)
- $\sigma_{extrapol.} \lesssim$ 1 μm avec e $^-$ (3 GeV, DESY)
- 2 étapes :
 - ♦ 2007: capteurs à signaux analogiques
 - \hookrightarrow télescope mis en service \mapsto déjà exploité
 - ◊ 2008: capteurs à signaux numérisés avec Ø intégrée
 - \hookrightarrow temps de lecture \sim 100 μs





Trajectométrie: Applications à Long Terme

Détecteur de Vertex pour l'ILC

- \circ 5–6 couches cylindriques (+ disques ?) : \gtrsim 3000 cm 2
- 300–500 millions de pixels (20–35 μm pitch)
- \circ temps de lecture \sim 25 (L0), 50 (L1) & 100 (L2-4) μs
- ullet 1er prototype d'échelle complète \gtrsim 2010



Détecteur de Vertex pour l'exp. CBM (FAIR/GSI)

- ullet 2 plans rectangulaires : \sim 500 cm 2
- 150 millions de pixels (pitch \sim 20 μm)
- $\circ~$ temps de lecture \sim 10 μs



Thin Film on ASIC (TFA) technology

P. Jarron, M. Depeisse et al. CERN

Novel solid state detector technology :

- Deposition of n-i-p a-Si:H films on top of the integrated circuit



TFA Concept

"Thick" TFA sensor cross section

LHC-SLHC Upgrades: quelques exemples

Tracker CMS

Si strips
Pixels

Augmentation de Luminosite @ LHC-SLHC





1. Amener le courant à + haute tension
Alim série (compliqué si différentes tensions, fiabilité,...)
Convertisseur DC-DC, radiations?

2. Refroidissement au CO₂ (Evaporative cooling)

Nouveaux modules Si + résistants aux radiations
Nouveaux modules Si + segmentés (strips +courts)
Nouveaux modules Si avec pads pour trigger

Horizon 2018-2020 ? Encore beaucoup de travail en vue...

Upgrade CMS pixels

Pourquoi?

•Dommages dus aux radiations sur pixels n-on-n

Design pour survivre ~300 fb⁻¹ (5 ou 6 ans après t_0 ou 3 ans @ pleine Lumi)

•Système de lecture prévu à l'origine pour r = 7cm @10³⁴



BPIX Options for 2013 replacement/upgrade

Slide from Jan 2009, R Horisberger

Proposal for

4 layer pixel system 4, 7, 11, 16 cm → 1216 full modules
 CO2 cooling based

Ultra Light Mechanics

• BPIX modules with long 1.2m long microtwisted pair cables

- Shift material budget from PCB & plugs out of tracking eta region
 ROC buffers for 1.5 x 1034 and serial binary readout @160 MHz
 Serialized binary optical readout at 320 MHz to old, modified px-FED
- •Recycle & use current AOH lasers → 320MHz binary transmission
 - Same FEC's, identical TTC & ROC programming

• Keep LV-power supply & push more current through cables



Solutions proposées

• Dommages dus aux radiations:

Sensors with p-type bulk, more rad-hard Submission with HPK, expected delivery early next year (2009)

Temps mort de lecture

OLD

0-suppressed analog coded data readout at 40MHz

NEW

0-suppressed serial binary data readout at 320MHz, same data structure

Weight of BPIX module



BPIX modules with 75 μ thinned down ROC's successfully fabricated !



FPix Phase 1 Upgrade Plans



Simon Kwan – Fermilab June 2009

Upgrade Design for FPIX MODULE LAYOUT



> 12 identical half-disks

> only 2x8 modules

One 2x8 module placed on each side of a substrate for all outer and inner radius blades

Substrate uses Thermal Pyrolytic Graphite – material with excellent in-plane thermal conductivity

Simon Kwan – Fermilab June 2009 Oléron juin 2009 P

Puzzle



D. Barney

Find 4 straight tracks.

P.Siegrist CERN-PH

Answer

Make a "cut" on the Transverse momentum Of the tracks: $p_T > 2 \text{ GeV}$



S. Cittolin



Conclusion

- Les Détecteurs de trace ont considérablement évolué en performances et en... complexité!
- A l'avenir vu le type de machines à démarrer ou annoncées, les détecteurs de traces (et ceux qui les exploitent) n'auront pas la vie facile...